

JEITA チップレットソリューションWG

■チップレット技術における必要な要件を調査し、標準等の整備を行う

- ・ 会員企業へ調査した最新情報を共有
- ・ チップレットのセキュリティーに関する国際標準化への対応

半導体標準化専門委員会

半導体システムソリューション技術委員会

チップレットソリューションWG(新設)

ヘテロジージャスインテグレーションTG(新設)

活動内容

- ・ 標準化や業界活動の動向調査 (HIR、Chiplet Summit)
- ・ 業界団体との情報交換会 (ASRA、SEAJ)
- ・ 情報共有のための勉強会

ヘテロジージャスインテグレーションとは

❌ ムーアの法則が頭打ちに

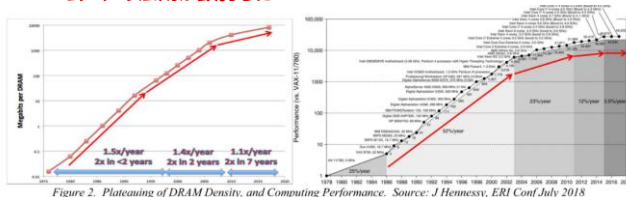


Figure 2. Plateauing of DRAM Density, and Computing Performance. Source: J Hennessy, ERI Conf July 2018

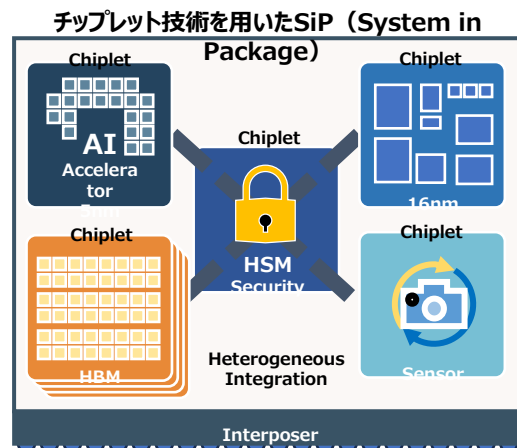
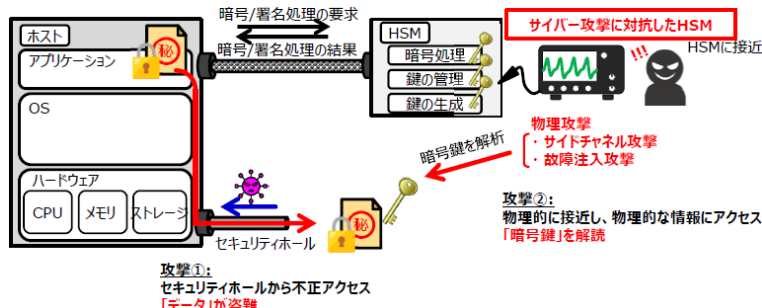
ハードウェアセキュリティー検討TG(新設)

活動内容

- ・ チップレットにおけるセキュリティー実装方法の議論
- ・ 国際的な動向の調査
- ・ IEC等における標準化への対応

ハードウェアセキュリティーにおけるHSM (Hardware Security Module) とは

HSMは、「サイバー攻撃耐性」は高いが「物理攻撃耐性」が低い



✅ ムーアの法則のスケールが遠い未来まで拡大する

Heterogeneous Integration

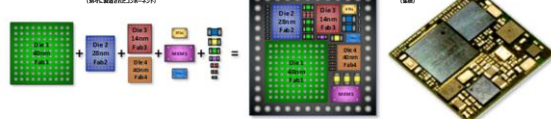


Figure 6. Heterogeneous Integration and System in Package (SiP). Source: ASE

出展: IEEE EPS
HIR

※WGに参加するためにはサブコミッティに所属する必要があります (年会費: ¥144,000/社)。

※サブコミッティ内のどのWGに、何人参加しても、同一料金です。

お問合せ先: 一般社団法人電子情報技術産業協会 事業戦略本部事業推進部担当: 岩淵・遠山
〒100-0004 東京都千代田区大手町1-1-3 E-mail: device3@jeita.or.jp

